

## Presseinformation

21. März 2017

Innovative Materialien ermöglichen intelligente Medizingeräte und strukturelle 3D-Elektronik

### Henkel präsentiert auf der LOPEC 2017 Materialsets für intelligente medizinische Pflaster und In-Mold-Elektronik

Düsseldorf – In Halle B0, Stand 401 auf der bevorstehenden LOPEC Fachmesse für gedruckte Elektronik ([www.lopec.com](http://www.lopec.com)) präsentiert das Geschäftsfeld Elektronik von Henkel Adhesive Technologies ([www.henkel-adhesives.com/electronics](http://www.henkel-adhesives.com/electronics)) einige beeindruckende Brancheninnovationen für umfassende Materialkonzepte bei gedruckten Elektronikanwendungen. Zu den neuesten hochwirksamen Lösungen des führenden Materialherstellers gehören innovative Formulierungen, die intelligente Medizintechnologie und -geräte unterstützen, sowie Produkte für In-Mold-Elektronikanwendungen.

#### Die Zukunft der Gesundheitsoptimierung und der medizinischen Diagnostik

Henkel leistet seit Langem wichtige Beiträge zur Medizinelektronik. Die neuesten Entwicklungen des Unternehmens werden „intelligente“ Technologien im Gesundheitssektor ermöglichen, die Echtzeitdaten für verschiedene menschliche Vitalparameter drahtlos verfügbar machen.

Kern des Henkel-Materialsets ist ein leitfähiger Loctite-Elektrodenlack in einem Einweg-Pflaster, das mittels eines hautverträglichen Haftklebstoffs auf der Haut befestigt wird. Der zweite Teil dieses intelligenten medizinischen Pflasters enthält eine Leiterplatte. Geschützt wird die Pflasterseite mit der Leiterplatte durch Beschichtungsprodukte von Henkel und Hotmelts für den Niederdruckverguss der Marke [Technomelt](#). Das Ergebnis ist ein funktionales Gerät, das die Herzfrequenz misst und die Werte an ein drahtlos verbundenes Gerät (Smartphone, Tablet, Laptop etc.) überträgt – so werden lästige Kabel und Steuergeräte überflüssig. Das intelligente Pflaster kann mehrere Tage getragen und mehrfach abgenommen und



wieder aufgebracht werden. Anschließend muss nur der Elektrodenteil entsorgt werden. Für die weitere Verwendung kann einfach ein neues Elektrodenpflaster auf den Leiterplattenteil aufgebracht werden. Die Technologie eröffnet ein breites Anwendungsspektrum zur Messung zahlreicher Körperfunktionen.

### **Integration von Form und Funktion mit struktureller 3D-Elektronik**

Die Zukunft modernen funktionalen Designs nimmt Formen an: Das Henkel-Portfolio an Materialien für die In-Mold-Elektronik wird ebenfalls am Henkel-Stand auf der LOPEC zu sehen sein. Mit dieser Technologie ermöglichen wärmeformbare leitfähige Lacke die Einbettung von Elektronikfunktionen in Kunststoff- und Vergussmaterialien, so dass auf herkömmliche Schalter, Knöpfe und Drähte verzichtet werden kann. Der Einsatz dieser neuartigen Technologie ist für zahlreiche Marktsegmente interessant.

So lassen sich beispielsweise bei Anwendungen in Kfz-Armaturenbrettern Funktionen wie Temperaturregelung, Innenbeleuchtung und Audiosteuerung in das Armaturenmateriale selbst integrieren und per Touch-Steuerung bedienen. Dies ermöglicht eine deutliche Gewichtsreduzierung, die ein wichtiger Aspekt für die moderne Fahrzeugentwicklung und -produktion ist. Ebenso kann die Elektronik bei herkömmlichen Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen jetzt direkt in das Gehäuse integriert werden, ganz ohne Tasten und Drehknöpfe.

Die Henkel-Lösung für In-Mold-Elektronik ist ein ganzheitliches, optimal abgestimmtes Materialset, das moderne wärmeformbare und leitfähige Lacke, leitfähige Klebstoffe und Lötpasten der Marke Loctite sowie Niederdruck-Vergussmaterialien der Marke Technomelt umfasst.

### **Technologie live**

LOPEC-Besucher sind herzlich eingeladen, am Henkel-Stand 401 in Halle B0 Produktmuster in Augenschein zu nehmen und sich über diese bahnbrechenden neuen Materialien zu informieren. Die in Zusammenarbeit mit dem Holst Centre (<https://www.holstcentre.com/>) entwickelten intelligenten medizinischen Pflaster sind auch Teil einer Live-Aktion mit Henkel-Mitarbeitern, die an den zwei Messtagen die Pflaster tragen. Die darüber erfassten Echtzeit-Herzfrequenzdaten werden auf Monitoren am Stand zu sehen sein.

Für Termine mit einem Henkel-Experten auf der LOPEC wenden Sie sich bitte per E-Mail an: [electronics@henkel.com](mailto:electronics@henkel.com). Weitere Informationen zu den Lösungen von

Henkel für gedruckte Elektronikanwendungen finden Sie unter [www.henkel-adhesives.com/electronics](http://www.henkel-adhesives.com/electronics).

### Über Henkel

Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen – sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd Euro. Allein die drei Top-Marken Persil, Schwarzkopf und Loctite erzielen dabei einen Umsatz von mehr als 6 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 50.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter [www.henkel.de](http://www.henkel.de).

**Fotomaterial finden Sie im Internet unter <http://www.henkel.de/presse>**

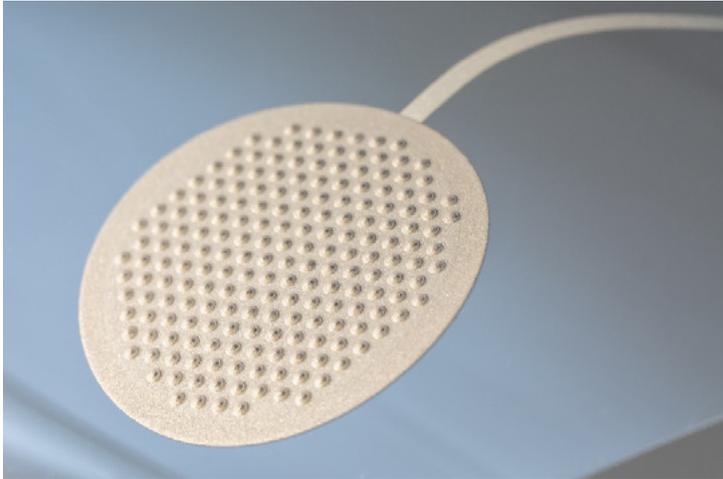
Kontakt Ines Behrendt  
Telefon +49 211 797 6076  
E-Mail [electronics@henkel.com](mailto:electronics@henkel.com)

Henkel AG & Co. KGaA

**Folgendes Fotomaterial ist verfügbar:**



Dehnbares Material für geformte und vergossene Elektronik.



Pflaster mit hautverträglichem Haftklebstoff.